

PALTEK、「国際物流総合展 2018」に出展 Ranpak 社の紙梱包資材活用による物流コストの低減を提案

株式会社PALTEK(本社:横浜市港北区、代表取締役社長:矢吹尚秀、証券コード:7587、以下PALTEK)は、2018年9月11日(火)から14日(金)まで、東京ビッグサイトで2年に一度開催されるアジア最大規模の物流・ロジスティクス専門展示会「国際物流総合展2018」に出展し、Ranpak社の紙梱包資材活用による物流コストの低減を提案いたします。

今回で13回目の開催となる国際物流総合展は、最新の物流システム機器や情報システム、サービス等ハードとソフトが集結し、国内外のロジスティクス関係者が一堂に会する、アジア最大の物流・ロジスティクスの総合展示会です。

Ranpak社の紙梱包資材システムは、同社独自の技術により高い緩衝能力を発揮し、梱包方法の最適化により梱包資材コストの低減、保管スペースの縮小などのトータルコストの大幅な削減を提案することができます。国際物流総合展2018では、大量梱包ライン向けのすき間埋め自動梱包システム「AccuFill®(アキュフィル)」の実演のほか、各物流ニーズにあわせた梱包システムを展示いたします。

● 展示会の概要

展示会名 : 国際物流総合展2018
 開催日時 : 2018年9月11日(火)～14日(金)
 10:00～18:00(14日のみ終了時間は17:00)
 会場 : 東京ビッグサイト(小間番号:東8-401)
 URL : <http://www.logis-tech-tokyo.gr.jp/>



● 主な出展内容

・大量梱包ライン向けすき間埋め自動梱包システム(AccuFill)

AccuFillは、すき間埋め用紙資材の量を最適化する自動梱包システムです。大量梱包ライン上の箱をAccuFillのセンサーがスキャンし、箱のサイズや箱内側の製品体積を測定し、すき間を埋めるために必要な紙資材の量を計算、FillPakコンバータに情報を送って必要な量の紙を排出します。



・高速すき間埋めシステム(FillPak®)

FillPakは、配送箱と製品とのすき間を高速に埋め、輸送中の揺れや衝撃を抑えます。ランダムに発生するさまざまなすき間を紙の柔軟性で容易に埋めることが可能です。



・衝撃保護用梱包システム(PadPak®)

PadPakは、1枚の紙を折り畳んで「ひだ」を作り、保護能力がある衝撃吸収パッドに変えます。できあがった衝撃吸収パッドは、箱の中のクッション材や固定材として自在に利用でき、壊れやすい製品や重量のある製品を保護します。



・ラッピングシステム(Geami WrapPak®)

Geami WrapPakは、特許を取得したダイカット(切り込み)入りクラフト紙と台紙の組み合わせで商品を守り、迅速な梱包と美しい見た目を両立します。



・コールドチェーン向け紙梱包ソリューション

コールドチェーン向け紙梱包ソリューションは、プラスチック系梱包資材と同等の輸送温度帯品質を保持しながら最大72時間、商品を輸送できることに加え、環境負荷の低減が可能なため、品質を重要視する冷凍食品やワクチンなどの医薬品の梱包にも活用できます。



Ranpak社について:

Ranpak社は世界初の環境問題に責任を持ったお客様の製品を保護する梱包資材を提供することを目標に1972年に設立され、世界に230社以上の代理店、400箇所以上の拠点を有する世界最大の紙による梱包資材・システムメーカーです。40年以上にわたる経験から紙による緩衝材とすき間埋めの特許を400以上有し、世界で6万社のユーザーに提供しております。

Ranpak BV は、欧州およびアジアに 100 以上の販売代理店を有しています。西ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリスなど)の成熟市場、東ヨーロッパ(ポーランド、スロバキア、トルコ)の発展途上市場、およびアジア太平洋(オーストラリア、日本、シンガポールなど)など、世界中に拠点があります。

Ranpak社に関する詳細は、<https://www.ranpak.com> をご覧ください。

株式会社PALTEKについて:

PALTEKは、1982年の創業以来、日本のエレクトロニクスメーカーに対して国内外の半導体製品の販売のほか、ハードウェアやソフトウェアなどの設計受託サービスも提供し、お客様の製品開発のパートナーとして仕様検討から試作開発、量産までサポートしています。

PALTEKは、「多様な存在との共生」という企業理念に基づき、お客様にとって最適なソリューションを提供することで、お客様の発展に貢献してまいります。

PALTEKに関する詳細は、<https://www.paltek.co.jp> をご覧ください。

■この件に関するお問い合わせは下記へお願いします。

1: ニュースリリースに関するお問い合わせ

株式会社PALTEK

担当者 : 広報担当 柴崎 由記

メールアドレス : pr@paltek.co.jp

所在地 : 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-12 新横浜スクエアビル 6F

電話 : 045-477-2072 FAX : 045-477-2012

2: 本展示会に関するお問い合わせ

株式会社PALTEK

担当者 : 国際物流総合展 担当者

メールアドレス : info_pal@paltek.co.jp

所在地 : 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-12 新横浜スクエアビル 11F

電話 : 045-477-2009 FAX : 045-477-2146